

# 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

## 2022 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 242,625,800 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### （一）公司简介

股票简称	劲拓股份	股票代码	300400
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	陈文娟		
办公地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）		
传真	0755-89481574		
电话	0755-89481726		
电子信箱	zqztb@jt-ele.com		

## （二）报告期主要业务或产品简介

### 1、主要业务及产品情况

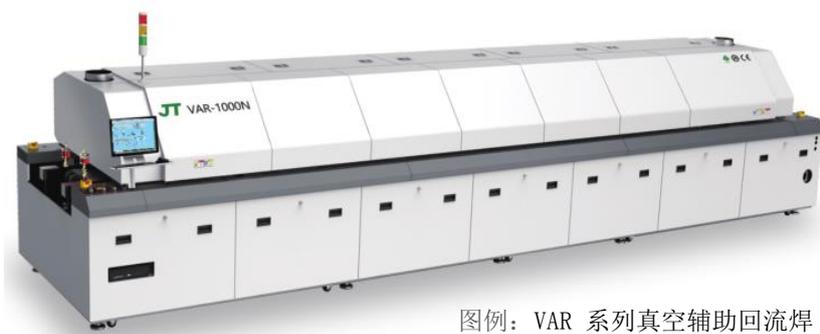
公司主要从事专用设备的研发、生产、销售和服务，主要产品按大类可以划分为电子装联设备（电子热工设备、检测设备、自动化设备）、光电显示设备和半导体专用设备。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### （1）电子装联设备

公司电子装联设备包括电子热工设备、检测设备和自动化设备，覆盖电子产品PCB生产过程中的插件、焊接、检测等多个流程，为客户提供整套零缺陷焊接检测制造系统，主要提供给下游电子制造企业，用来组建电子工业中的PCBA生产线，该类设备能够广泛应用于汽车电子、通信设备、消费电子、航空航天、其他电子产品的生产过程。

##### ① 电子热工设备主要产品及应用领域

电子装联设备中的电子热工设备由公司自主研发、生产和销售，拥有温度控制及传热方面的核心技术，此类产品主要功能是将表面贴装元器件与PCB进行组装，应用于电路板制程领域。



图例：VAR 系列真空辅助回流焊

#### 真空回流焊

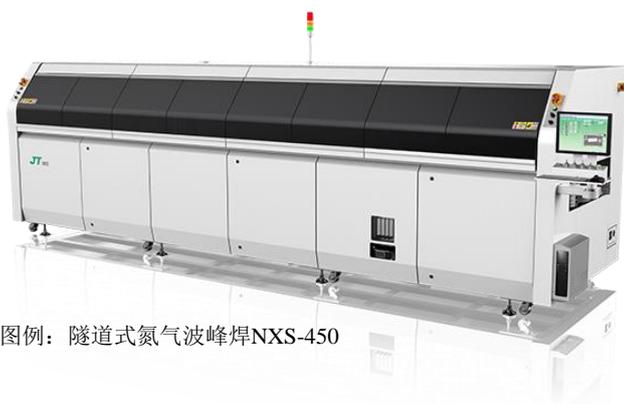
系列产品可用于车载控制板及LED、新能源IGBT模块、通讯电子、5G等。

#### 热风（无铅）回流焊

系列产品可用于Mini LED直显和背光的IMD、COB、COG等封装工艺，以及家电电子PCB、小功率电源板、一般电子控制板、LED等产品制造，能够满足智能手机、通讯、汽车电子、服务器、航空等高品质要求的产品。



图例：无铅(氮气)热风回流焊



图例：隧道式氮气波峰焊NXS-450

■ 无铅(氮气)波峰焊锡装置

系列产品可用于储能产品、服务器类主板、充电桩大功率电源主板、高端汽车电子产品，以及白色家电电子PCB、小功率电源板、一般电子控制板等制造过程。

■ 立式固化炉

用于手机主板、电脑主板、电视主板、通讯主板、新能源等相关电子产品的生产。



图例：JTL系列立式固化炉

② 检测设备主要产品及应用领域

公司电子装联设备之检测设备拥有运动控制和视觉识别方面的核心技术，主要功能是在电子产品生产中对PCB上焊点和元器件进行检测，应用于电路板组装制程领域，与电子热工设备组成SMT生产线。



■ 波峰炉前



■ Reflow炉前/炉后



■ 1.2M长板/背光



■ DIP 元件

• 自动化光学检测设备 (AOI)

能够应用于贴片工艺错件、漏件、反向、焊接不良、偏位，以及波峰焊后的焊点、错件、漏件、反向，炉前错件、漏件、反向等情形的外观检测。



■ DIP +SMT元件双面检测



#### 自动锡膏检测设备 (SPI)

用于 PCB 板印刷后检测出锡膏或者红胶的厚度、面积、体积、偏移的分布情况，能够满足于汽车 LED 灯板，电池连接器等超大尺寸 PCB 板以及手机、Mini LED 等密度高、元器件精密的 PCB 板检测需要。



### ③ 自动化设备及应用领域

电子装联之自动化设备主要为与公司电子热工设备和检测设备配套使用的相关设备，包括异形插件机、助焊剂喷雾机及其他电子热工周边设备等。

#### 全自动异形元件插件机

- 卧式系列
- 立式系列

主要功能是对各种规格的散装料或排插等异形电子元器件的自动化插件处理。



### (2) 半导体专用设备

公司半导体专用设备包括半导体热工设备和半导体硅片制造设备，半导体热工设备是用于芯片的先进封装制造等生产环节的热处理设备，半导体硅片制造设备则用于半导体硅片生产过程。公司半导体专用设备目前主要有半导体芯片封装炉、Wafer Bumping 焊接设备、甩胶机、氮气烤箱、半导体硅片制造设备等，主要客户及潜在客户为半导体封测厂商、半导体器件生产厂商和半导体硅片生产厂商等。

#### 半导体芯片封装炉

应用于各类芯片元器件的封装过程



■ Wafer Bumping 焊接设备

主要应用于晶圆级封装 (WLP)



■ 无尘氮气烤箱、无尘压力烤箱

主要应用于胶水静置和固化，整体提高产品可靠性。



■ 半导体甲酸真空炉

适应新能源IGBT封装、大功率器件、圆晶级先进焊接工艺，满足真空环境下不同合金材料的高温焊接要求。



■ 半导体Clip Bonding真空炉

主要应用于Clip Bonding工艺的功率器件。

(3) 光电显示设备

光电显示设备用于光电平板 (TP/LCD/OLED) 显示模组的生产制造过程，按功能分类主要有3D贴合设备、生物识别模组生产设备、LCM焊接类设备、贴附机等，相关产品已经覆盖AMOLED柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片贴合等多种应用领域，主要客户为国内大型面板制造商和模组生产商。



3D曲面贴合设备

应用于贴合装饰膜、防爆膜、Sensor膜、光学膜等。

D-Lami 贴合设备

应用于柔性OLED屏与曲面玻璃盖板的贴合。



屏下指纹模组全自动邦定&贴附设备

用于指纹识别Sensor与FPC（柔性线路板）之间的邦定连接，以及超声波指纹模组IC+Sensor贴合、光学指纹模组的贴合、贴附、封边点胶及固化等。

## （二）主要经营模式

### 1、销售模式

公司产品目前以内销为主，报告期境内销售收入占比93.29%。公司采取订单直销为主，代理商销售为辅的销售模式，报告期直销销售收入占比88.47%。公司建立有独立的销售团队，辅以代理商销售形式，销售网络遍及全国。针对核心大客户，以业务经理负责的模式专人跟进业务合作情况，为客户提供一站式、定制化解决方案，增强大客户粘性、增加合作深度。公司针对研发创新产品，及时向客户进行推广、更新产品宣传信息，同时通过参加或举办展会、招标会、行业活动等方式在特定范围内开展定向或不定向的宣传。针对有意合作的潜在客户，公司采取上门推广、定向联系的形式进行针对性客户开发。公司注重售后服务质量，通过高质量的售后服务增进客户沟通、增强客户粘性，同时敏锐地把握客户需求、及时为客户提供升级换代产品或替换产品。

### 2、生产模式

公司实行“以销定产”的生产模式，即根据销售订单来制定公司的生产计划。在电子热工设备、检测设备、自动化设备生产方面，公司拥有钣金、机加及装配等完整的全工序生产制造体系，能够采取自主标准化生产模式。在光电显示设备生产方面，产品属于专用设备，定制化特点突出，产品种类型号较多，在生产实践中公司总结了一套与此特点相适应的小量多批次的柔性化生产模式，能够根据客户需求

进行定制化生产。在半导体专用设备生产方面，根据产品特点，采用标准化生产与定制化生产相结合的生产模式。公司下设PMC部全面负责协调管理生产系统的工作，由PMC部按销售部门下达的订单指令进行科学排产和安排生产，并协调符合生产节奏的原材料入库、产品生产、产品测试、质量控制和产品发运全过程，同时辅助以SAP数据系统，对生产成本进行有效管控、贯彻精益生产要求。

### 3、采购模式

公司根据PMC的科学排产计划，结合不同类型原材料、零部件采购特性，遵循采购单的规范流程实施采购。采购全过程严格遵循“同一质量水平比价格、同一价格水平比质量、同一质量价格水平比服务”的三比采购原则，在合理控制成本、与生产计划充分衔接的前提下选择合适的标的，磋商采购交易细节。公司严格根据销售、生产和原材料消耗情况，确定短期采购需求，避免存货积压。公司严格按照《供应商评审与管理程序》对供应商的品质、供货能力进行详细评审，通过评审的供应商再由公司进行择优选择；公司会择优选择供应商，保证产品质量和客户满意度；在关键物料方面，公司主要采用知名品牌产品，与供应商建立长期合作关系，确保供货稳定及时；在常规物料方面，在保证产品品质及交期的前提下，公司会通过询、比、议价，选择品质稳定、价格更优的产品和供应商。在半导体设备等高端产品方面，对物料技术要求较高，公司主要采购有技术支持的知名品牌产品，保证物料性能和品质。

### （三）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入79,117.78万元，同比减少19,800.06万元；实现归母净利润8,910.33万元，同比增加912.77万元，主要业绩驱动因素包括：

#### 1、传统消费电子需求疲软，电子装联业务承压，新型硬件蕴含结构性机会。

随着近年来全球经济不确定性增加，传统消费电子需求减少、固定资产投资放缓。公司电子装联业务报告期销售收入同比减少18.66%，其中，电子热工业务实现销售收入58,540.80万元、同比减少17.40%；电子热工业务2022年下半年销售收入较2022年上半年环比增加23.88%，呈现回暖态势。

公司电子装联设备广泛应用于汽车电子、智能穿戴设备、智能家居等领域硬件生产过程，随着新型硬件市场需求增长，以及新能源汽车、物联网、5G通讯技术带来的硬件需求更新，新型硬件有望带来下游行业的结构性机会。加之中国内地消费电子行业逐步呈现复苏态势，公司凭借在电子热工等领域积累的领先优势，电子装联业务景气度有望回暖。

#### 2、半导体相关业务成长性初显，光电显示业务蓄力待发。

报告期内，公司半导体相关业务销售收入2,780.57万元，同比增长1,382.09%，战略级业务成长性初显；其中，在半导体专用设备方面，公司半导体热工设备和半导体硅片制造设备方面均实现关键技术突破，产品线进一步延伸。截至报告期末已累计交付20余家半导体行业客户，产品得到验收及复购。

公司光电显示业务继续与客户战略合作、保持业务连续性，在行业景气度低迷形势下稳扎稳打、夯实根基，为把握市场修复机遇增能蓄力，报告期内公司光电显示设备毛利率提高，实现销售收入3,355.52

万元。

### 3、落实产品创新、精益生产措施，提高产品附加值增厚业绩。

产品结构升级是公司夯实整体和产品核心竞争力的根基，为公司主营业务长足发展带来不竭动力。公司产品和技术创新、销售和服务能力延展，带来较高毛利率产品放量、产品结构相应调整；加之公司持续落实精益生产措施、降低制造费用，实施供应链管控、减少直接成本消耗，报告期内公司产品综合毛利率较同期提高7.56个百分点。

### 4、其他因素。

公司存在减值迹象的资产予以及时充分计提减值；第一期、第二期员工持股计划及限制性股票之股份支付费用，根据《企业会计准则》要求在考核期内分摊。报告期内，美元汇率波动致使财务费用减少，资产减值客观减少对经营业绩产生影响。

## （四）主要会计数据和财务指标

### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末 增减	2020 年末
总资产	1,238,909,784.86	1,231,839,311.01	0.57%	1,182,209,226.79
归属于上市公司股东的净资产	740,978,028.92	747,809,852.71	-0.91%	673,487,061.63
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	791,177,847.70	989,178,447.86	-20.02%	883,796,809.80
归属于上市公司股东的净利润	89,103,329.41	79,975,673.48	11.41%	122,738,020.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,567,969.57	61,515,680.10	24.47%	108,648,137.86
经营活动产生的现金流量净额	129,064,893.85	17,626,349.28	632.23%	262,339,807.14
基本每股收益（元/股）	0.37	0.33	12.12%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.33	9.09%	0.51
加权平均净资产收益率	12.13%	11.30%	0.83%	20.71%

### 2、分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	129,526,073.78	210,407,693.44	214,585,520.25	236,658,560.23
归属于上市公司股东的净利润	6,715,726.36	28,323,526.03	35,988,260.07	18,075,816.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,157,661.53	26,035,148.65	28,731,226.93	17,643,932.46
经营活动产生的现金流量净额	-8,755,510.74	59,516,805.71	16,375,268.59	61,928,330.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## (五) 股本及股东情况

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,657	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,007	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
吴限	境内自然人	32.86%	79,729,018.00	0.00	质押	33,568,182.00			
麦旺球	境内自然人	2.25%	5,467,149.00	0.00					
主遼	境内自然人	2.10%	5,083,435.00	0.00					
中国工商银行股份有限公司—博时信用债券投资基金	其他	1.90%	4,600,000.00	0.00					
麦容章	境内自然人	1.58%	3,822,271.00	0.00					
邱子聪	境内自然人	1.54%	3,735,000.00	0.00					
孙见清	境内自然人	1.52%	3,700,000.00	0.00					
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.22%	2,960,820.00	0.00					
许惠敏	境内自然人	1.07%	2,585,700.00	0.00					
深圳市尚桦投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	2,358,767.00	0.00					
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中麦旺球与麦容章系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。								

公司是否具有表决权差异安排

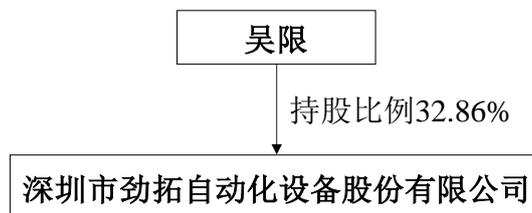
适用 不适用

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## (六) 在年度报告批准报出口存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

1、公司于报告期内以 2022 年 5 月 26 日为股权登记日实施了 2021 年度利润分配，合计派发现金红利人民币 119,832,490.00 元（含税），具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-025）。

2、公司 2022 年 10 月 18 日披露拟实施 2022 年限制性股票激励计划、第二期员工持股计划相关事项，随后经 2022 年 11 月 3 日 2022 年第四次临时股东大会审议批准，股权激励计划、员工持股计划具体实施情况详见《2022 年年度报告》“第四节 公司治理”之“十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

3、公司报告期间内经第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次会议决议，根据中国证监会、深交所相关法律法规、规范性文件规定，对公司内部控制制度进行集中修订，并分别经 2022 年 9 月 6 日 2022 年第二次临时股东大会、2022 年 10 月 11 日 2022 年第三次临时股东大会审议批准，与时俱进地完善内部控制制度体系。

4、公司第四届董事会、监事会任期于报告期内届满，经职工代表大会决议，以及 2022 年 5 月 17 日 2021 年度股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议决议，公司完成了第五届董事会、监事会成员选举，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计负责人。

同时，为不断完善治理结构、更好地满足业务发展和资源整合需要，公司于报告期内补选了部分董事，董事会人员构成相应变化。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日